

## Micron和Intel合作，以高性能封裝疊加記憶體解決方案 增強Knights Landing

為下一代計算提供低功耗、頻寬極高  
的記憶體解決方案

愛達荷州博伊西，2014年6月24日（GLOBE NEWSWIRE） -- 世界領先的先進半導體解決方案供應商之一，Micron Technology, Inc.（納斯達克股票代碼：MU）今日宣佈與Intel合作，為Intel下一代Xeon Phi(TM)處理器提供封裝疊加記憶體解決方案，其研發代碼為Knights Landing。該記憶體解決方案是這兩家公司為了衝破記憶體壁壘的長期合作成果，其採用了基本的DRAM和堆疊技術，後者也被Micron混合記憶體立方產品使用。

“生態系統正在改變，可擴展封裝疊加記憶體和記憶體頻寬的重要性已變得眾所周知，” IDC調研經理Chirag Dekate說到。“記憶體使解決方案的核心，大計算和大資料都將從中獲益匪淺。此次產品發佈清晰地說明了Micron是如何推動記憶體在系統中的作用和影響，以及3D記憶體的價值。”

該記憶體的持續記憶體頻寬達到DDR4的5倍，每比特能耗僅為其三分之一，佔用面積僅為其一半，Knights Landing高性能封裝疊加記憶體將高速邏輯和DRAM層合併到一個經優化的封裝中，將為性能和能耗設置新的行業標杆。記憶體堆疊優化了可靠性、可用性和可服務性，這是高性能計算系統的關鍵因素。Knights Landing系統的首次應用之一 -- 下一代Cray XC超級電腦 -- 於4月29日由NERSC推出。

“Intel的多集成核心（MIC）結構加上Micron的高性能記憶體是一種強大的組合，” Micron計算和網路事業部副總裁Tom Eby說到。“Intel和Micron的先進技術成功地將處理器嫁接到記憶體系統，該記憶體系統非常罕見地將低功耗和超大頻寬相結合。”

“下一代Intel(R) Xeon Phi(TM)處理器，研發代碼為Knights Landing，其發佈時將具備16GB高性能封裝疊加記憶體，其持續記憶體頻寬比DDR4大幅度提高，帶來極高的能源利用率並極大節省空間。這是第一款使用這種新型高性能封裝疊加記憶體的Intel HPC處理器，” Intel工作站和高性能計算資料中心集團副總裁兼總經理Charles Wuischpard說到。“這將使全球頂尖的研究人員、科學家和工程師能夠更加快速地運行更大的工作負載，同時只需維持當前的代碼投資。能與Micron合作交付這種記憶體，我們深感榮幸。”

欲知更多Micron管理的高性能記憶體解決方案詳情，請訪問 <http://www.micron.com/products/hybrid-memory-cube>。

## 關於Micron

Micron Technology, Inc.是全球領先的先進半導體解決方案供應商之一。通過它遍佈全球的運營，Micron為先進的計算、使用者、網路、嵌入式和移動產品生產和銷售全套DRAM、NAND和 NOR快閃記憶體，以及其他創新的記憶體技術、封裝方案和半導體系統。Micron的普通股在納斯達克上市交易，代碼是MU。欲瞭解有關Micron Technology, Inc.的更多資訊，請訪問[www.micron.com](http://www.micron.com)。

(c)2014 Micron Technology, Inc.版權所有。資料若有修改，恕不另行通知。Micron和Micron orbit徽標為Micron Technology, Inc.商標。其他商標分別為其各自所有者財產。本新聞稿包含有關高性能封裝疊加記憶體可用性的前瞻性陳述。實際情況或結果可能與前瞻性陳述中包括的內容不同。請參考Micron和證券交易委員會定期發佈的匯總檔，特別是Micron最新的10-K和10-Q表。這些檔包含並確定導致匯總檔中的內容與前瞻性陳述不同的重要因素（見“某些因素”）。儘管我們認為前瞻性陳述中所反映的預期是合理的，但我們不能保證其未來結果、活動程度、性能或成就。

聯繫方式：公共關係聯繫方式：

Greg Wood

Zeno Group for Micron Technology

650-801-7958

[Greg.Wood@zenogroup.com](mailto:Greg.Wood@zenogroup.com)